

# 視覚認識装置付 全自動(インライン型)印刷機・MKシリーズ

世界最高クラスの印刷位置合わせ繰り返し精度を実現(±0.015mm)！  
ベーシック～フルスペックモデルまで、多彩なラインナップでニーズに応えます！



## 特徴

画像認識機能により、位置合わせ繰り返し精度:0.015mm以下を実現 0.2mmBGAパンブ  
や0.3mmピッチQFP等のファインピッチ印刷に対応します。

高精度多軸サーボモーター搭載により、基幹動作の安定性を極限まで高めました。

局部的に微細部品高密度エリアを持つ基板のための2段階膜厚印刷機構(888SV/M/L/LL)、  
集合基板用の多数枚搬送位置決め機構(888MA/WA)他、機種別にユニークな機能を網羅。

## 仕様

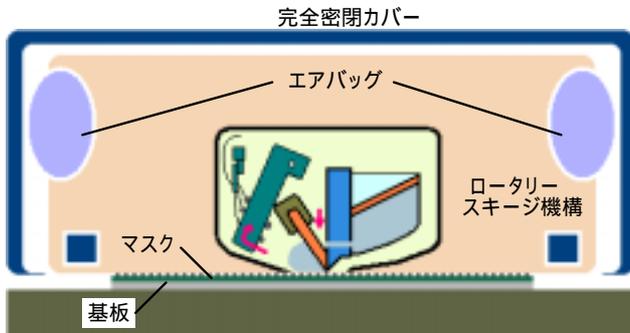
仕様項目	機種・型番	MARK			831SV	888SV				
		A	B	L		M	L	LL	MA	WA
・対応版枠寸法(X×Y)(*))	450×450mm									
	600×550mm									
	650×550mm									
	750×650mm									
	29'×29'									
	750×750mm									
・対応基板サイズ(**)	最小	X	50mm		50mm	50mm	100mm	50mm	150mm	
		Y	50mm		50mm	50mm	100mm	50mm	70mm	
	最大	X	330mm	460mm	200mm	330mm	460mm	540mm	330mm	180mm
		Y	250mm	300mm	200mm	250mm	360mm	500mm	250mm	200mm
・繰り返し精度(印刷位置合わせ)		±0.015mm以下			±0.015mm以下	±0.015mm以下				
・基板固定方法(***)	U								-	-
	S		-		-	-	-	-	-	-
	Y		-		-	-	-	-	-	-
・基本サイクルタイム(****)		8秒台	9秒台	条件による	8秒台	11秒台	ワーク&条件による			
・機能/機構 :標準装備 :オプション -:対象外	ロータリースキージ		-							
	自動印圧調整機能									
	セラミック基板搬送機構		-							
	加圧式版抜け機構		-							
	C/V自動幅調整機能		-							
	サーボクリーニング機構									
	自動基板反り矯正機能								-	-
	位置決めマニピュレータ		-		-	-	-	-	-	-
	多数枚搬送位置決め機構		-		-	-	-	-	-	-
	2段階膜厚印刷機構		-		-	-	-	-	-	-
A・B両面同時印刷機構		-		-	-	-	-	-	-	

(\*) 適合版枠厚は、t25～t40mm (\*\*\*) 対応基板厚:0.4～2.5mm(全機種共通) (\*\*\*\*) スキージ移動時間および版離れ時間を除く

(\*\*) U=ユニバーサルブロック(磁石固定)による基板吸着及び外形Yクランプの併用 / S=専用治具によるワーク吸着 / Y=専用治具による基板吸着および外形Yクランプの併用

### 加圧式版抜け機構

エア圧で、ペーストを開口部に押し入れる機構。版抜けしにくいファインピッチ印刷に威力を発揮。



### ロータリースキージ機構

ハンダペーストのラミネートパック供給方式が酸化を防止するので劣化の激しい鉛フリー塗布に最適

